

VCCS (Vehicle Communication Comfort & Safety)



自動車／MaaS市場

自動車業界の大変革期に戦略的価値を創出

ー安全・快適なモビリティサービスの実現に向けてー

柳澤 勝平

取締役 兼 執行役員常務／VCCS事業部長
VCCS海外工場統括／管理本部長／富岡工場統括



現在、自動車業界はかつてない規模の変革期を迎えています。CASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）やADAS（先進運転支援システム）、SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）の進展、EV市場の急拡大、さらにはGHG（温室効果ガス）排出量削減に向けた環境対応など、事業環境の急速な転換が進行中です。ヨコオは、こうした変化を単なる脅威ではなく新たな成長機会と捉え、より先進的かつ高い価値を持つ製品の開発を加速させています。同時に、製品原価から事業構造に至るまで徹底的な改革を通じ、安定的に収益を生み出す体制の構築に取り組んでいます。

世界最高水準の車載アンテナで安全・快適なモビリティを実現

VCCS (Vehicle Communication Comfort & Safety) ビジネスユニットは、安全で快適なモビリティサービスを実現する車載アンテナを開発・製造しています。代表的な製品であるシャークフィンアンテナは、低周波から高周波までをカバーし、自動車メーカーの高度な通信ニーズに応えています。

車載アンテナは、長年にわたり蓄積してきたアンテナ技術およびマイクロウェーブ技術を基盤とし、さらにモジュール化技術の導入によって、次世代通信に対応する革新的な製品群へと進化を遂げています。製品開発においては、電磁界シミュレーターや5G対応のミリ波帯電波測定サイトなど、最先端の開発・測定設備を活用し、世界最高水準の製品開発を実現しています。

製品は主に中国、ベトナム、フィリピンの各拠点で生産しており、海外生産比率は90％以上に達しています。また、販売先の約70％が海外市場であり、米国やASEAN諸国など、グローバルで主に日系自動車メーカー向けに展開されています。

VCCSセグメント展開領域



加速する自動車開発スピードへの対応

近年、自動車メーカーによる開発スピードが大幅に加速しています。従来は4～5年程度とされていたモデルチェンジのサイクルが、現在ではおよそ2年へと短縮されつつあります。開発がスピードアップ、高度化・複雑化するなかで、体制強化が求められており、迅速な対応を可能とするべく、インフラの整備と先行開発への取り組みを強化しています。また、従来以上に密

度の高いすり合わせが必要となり、それに応じた積極的な提案力が、開発パートナーとしての信頼構築に不可欠となっています。当社では、主要な自動車メーカーと先行開発段階から緊密なディスカッションを重ね、今後求められる技術や仕様について深い議論を行っています。

特に通信制御ユニット（TCU）とアンテナの一体化といった先端領域においては、安全性や機能性をさらに高めるために、自動車メーカーとの密接な協働が極めて重要です。当社は主要メーカーとの技術的コミュニケーションを強化し、現場レベルでの理解と信頼の深化を図っています。

収益構造の再構築とグローバルな生産体制の強化

5年目を迎えた事業構造改革は、固定費削減とともに、中国からベトナム、さらにフィリピンへと生産移管を進めたことで、収益改善、生産体制の重層化に大きく貢献しました。この取り組みは一過性の対応ではなく、継続的な改善を前提としたものであり、改革の成果を定着させるために、今後も先手を打つ形で生産体制の最適化を進めていきます。

生産拠点の拡大、サプライチェーンの複雑化に伴い在庫水準の上昇が見込まれる一方で、現地調達率の向上による在庫保有日数のミニマム化を同時に進めています。中国では現地調達率が80％に達しており、ベトナムは40～50％、フィリピンはまだ低い水準にあるものの、今後の重点エリアとして現地調達率の向上を図っていきます。

また、設備投資では、モジュール化・標準化を進めるとともに、「ローコスト・オートメーション」をコンセプトとしミニマム投資による投資効率向上を推進し、設備の共有化と汎用化による生産性向上と柔軟な生産対応力の確保を両立しています。

2025年の事業展開と通信技術開発の展望

今後はアンテナと通信制御ユニット（TCU）のモジュール一体型製品の開発が、重要な技術領域となります。これは車載通信機器の高度化に対応するものであり、自動車業界におけるコネクティビティ（接続性）ニーズの高まりに呼応する重要な技術基盤となります。また、当社は従来の自動車市場にとどまらず、モビリティ領域全体に事業を拡大する構想を描いており、新たな市場の開拓に着手しています。

こうした新領域への展開を支える仕組みとして、インキュベーションセンターとマーケティング部門との連携を強化し、技術シーズと市場ニーズの統合的な検討を通じて新たなビジネスの創出を進めています。自動車の進化に対応した次世代製品の提案を進めるとともに、中国やインドなど需要拡大が見込まれる新興市場では、標準製品を軸とした収益基盤の確立を図っています。特にインド市場では、当社のシェアが順調に拡大しており、今後も確実な成長が期待されています。

これらの活動は、新たなマーケットの創出とグローバル展開の両輪として、今後の成長戦略の中核を担います。一方で、今後の製品・サービスの差異化において、ソフトウェアの強化が不可欠です。特にTCUメーカーとの連携を通じて、自社の競争優位を形成する「強み」としてソフトウェアを位置付けています。今後、ソフトウェアとハードウェアの融合による価値創出が、成長の鍵となると考えています。

自動車市場の変化とヨコオの次世代対応力

近年、自動車の販売台数は一部地域でピークアウトの兆しを見せており、今後は「所有から利用へ」というモビリティの価値観の転換が加速すると予測されています。こうした市場環境の変化を踏まえ、コネクテッド技術を活用した新たなビジネスモデルの構築が重要性を増しています。VCCSはこの流れに対応するため、モビリティサービス分野における対応力の強化を進めています。次世代のモビリティ社会においても、価値ある技術・サービスを通じて新たな価値創出を実現していきます。

CTC (Circuit Testing Connector)

半導体検査装置市場

半導体検査分野を支える高精度技術の展開

ー総合テストソリューション型ベンダーへー

川田 直樹
執行役員／CTC事業部長



CTC (Circuit Testing Connector) ビジネスユニットは、ヨコオの微細精密加工技術を生かし、コンタクトプローブおよび回路検査用コネクタを製造しています。半導体製造の前工程で使用されるプローブカードや、後工程のソケットとして精密かつ高い性能を実現しています。

日本、マレーシア、ベトナムに生産拠点をもち、海外生産比率は70％超、販売も海外向けが90％以上と、グローバル展開が進んでいます。後工程用プローブは、マレーシア工場に加え、2022年設立のヨコオ・ベトナム工場でも生産を拡大中です。日本工場では、高難度な開発・量産製品に対応し、自動組立・検査ラインを導入。技術進化と市場変化に即応した生産革新を進めています。

半導体市場の変化とCTCの取り組み

半導体業界は変化が非常に激しく、主要企業の顔ぶれが1～2年で入れ替わることも珍しくありません。2020～2022年度はPCやスマートフォン向け半導体の需要で成長しましたが、2023年度には急減。一方で、2024年度は生成AIの普及により新たな需要が急速に立ち上がっています。

CTCビジネスユニットの検査治具は、CPU、GPU、メモリなど用途が異なる半導体にも基本的に同一製品で対応できる柔軟性を持ち、これが大きな強みです。現在、当社製品が主に対応するのは4つの主要市場で、それぞれに中核となるキーデバイスがあります。

対象市場	キーデバイス
データセンター／クラウド	CPU
	GPU
コンシューマー	SoC／AP
	無線トランシーバー
カーエレクトロニクス	アナログデバイス
産業用通信機器	無線トランシーバー
	RFフロントエンドデバイス

4つの主要市場のキーデバイス製造においては、当社の高周波対応力などを生かした回路検査用コネクタの提供が不可欠です。

データセンター／クラウド市場 (CPU／GPU)

2024年度、生成AIを支えるNVIDIA製GPUの需要増により、データセンター向け半導体が急成長しました。2025年度も生成AIの普及を背景に、高性能GPUやAIアクセラレータの需要は堅調と見込まれます。これらは消費電力や発熱量が大きく、放熱や信号品質対応が必要です。CTCは、これら新しい検査ニーズに対応し、システムレベルテスト市場の開拓と販路拡大を進めています。

コンシューマー市場 (SoC／AP／無線トランシーバー)

スマートフォンに加え、新型スマート端末やウェアラブルなど、エッジAI対応の需要が高まっています。これにより、高性能・省電力なAPの進化が加速しています。この分野は今後、半導体市場の中でも最大規模の成長が見込まれており、CTCは新たな需要を取り込み、市場開拓を進めていきます。

カーエレクトロニクス (アナログデバイス)

自動車のEV化・自動運転化により、パワー半導体やセンシング用SoCなどの需要が増加しています。特に高温・大電流など車載特有の環境に対応した高信頼製品が求められています。CTCでは、新素材や高度な表面処理技術を導入し、高耐久のアナログデバイス向け検査を開発・供給しています。

産業用通信機器 (無線トランシーバー／RFフロントエンドデバイス)

5GやIoTの進展により、工場やプラントのリアルタイム制御用途で通信半導体の需要が拡大しています。省電力で高信頼な制御ICやセンサーが重要です。CTCは、高周波対応技術を生かし、無線トランシーバーやRFフロントエンドデバイス用検査コネクタを提供し、確かな信頼を築いています。

検査工程のカバー範囲拡大による成長

CTCビジネスユニットでは、半導体検査分野での成長を目指し、検査工程の対象範囲を広げています。従来は後工程領域などに注力してきましたが、前工程のプローブカードへの展開を進めています。

半導体は2ナノメートル世代に入り、異種チップを同一パッケージに収める「チップレット実装」が主流になりつつあります。これにより、検査にはより狭ピッチ・高周波・高精度・高速信号への対応が必要とされています。

こうした技術要求に応えるため、当社は高周波・高速検査技術に加え、内製加工の高度化とMEMS技術の外部連携を進め、先端ニーズに対応する体制を構築しています。

具体的には、5Gデバイス向けソケットや高周波電子部品向けプローブカード (YPX) などの製品を拡充し、ターンキー型ソリューションで高付加価値な提案も強化しています。

特に前工程市場は後工程の2.5～3倍の規模があり、多くの顧客ニーズを背景にビジネス拡大のチャンスと捉えています。ただし競合も多く、技術的優位の確保が不可欠です。

半導体検査の工程と参入目標時期

	前工程検査		中工程検査	後工程検査		
検査Stage	再配線前Wafer Test	再配線後Wafer Test	Wafer Level Test (RF Test含む)	Final Test	System Level Test	Burn In Test
参入目標	2026年	既存拡大	既存拡大および新テスト用途獲得		2025年	2025年
技術戦略	電鍍チューブSpring Probe MEMS Probe / Sheet			高温大電流／Chiplet／内製進化		成型強化
対象デバイス	DRAM / NAND		Logic SoC SAW / BAW	Logic SoC (HBMメモリ内蔵)	Logic SoC / Chiplet	
事業戦略	M&A／アライアンス (製造) ＋ 製造体制強化 (省人化)		Field Support強化＋製造体制強化 (省人化)		M&A／アライアンス開発＋ 製造体制強化 (省人化)	

新たなテストニーズに応える柔軟な開発・生産体制の構築

CTCビジネスユニットでは、半導体市場の変化に即応するため、テストニーズへの対応力と開発・生産の迅速化を強化しています。鍵となるのは、各市場の技術ロードマップの理解と顧客との連携です。

業界では毎年主要プレーヤーが入れ替わる激しい変動があり、当社はそれに対応できる柔軟なビジネスモデルを構築しています。約4年前から部門横断のプロジェクトにより、部門間連携と技術戦略を推進し、最新の市場要求に応えられる製品と製造技術の開発を行っています。

また、半導体産業の立ち上がりサイクルが短くなるなか、当社は追従ではなくけん引する姿勢を重視し、アジャイルと柔軟性を両立した迅速な開発・量産体制を構築しています。

総合テストソリューション型ベンダーへの進化とグローバル展開

CTCビジネスユニットは、半導体検査の総合ソリューション提供を目指し、内製化とアライアンスを柔軟に使い分けています。製品微細化や使用方法に応じた製品微細調整などのコア技術は内製化し、開発制御とノウハウ蓄積を重視。一方で、スピードが重要な局面では外部と連携し、開発から製造まで一貫して価値を提供できる体制を整備しています。プローブやハウジング、拡張基板などの供給を通じて、サプライチェーン全体を見渡すエコシステムの中核的存在であることを目指しています。グローバル展開では、人口成長と家電需要が高まるアジア・インド市場と、生成AIや高性能半導体の開発を主導する米国市場の二極戦略を展開します。さらに、ROICを事業判断に導入し、投資効率を意識した経営を推進。現場レベルでの判断にも経営視点を浸透させ、迅速で合理的な意思決定体制を整えています。今後もCTCビジネスユニットは、高精度かつ高収益な製品ポートフォリオを拡充し、安定成長と新たな市場創出を両立していきます。

FC (Fine Connector)



スプリングコネクタ開発・提供

微細な「スプリングコネクタ」をグローバルに開発・提供

—顧客価値の創出によるコネクタソリューションプロバイダへの進化—

石橋 史章

執行役員／FC事業部長



FC (Fine Connector) ビジネスユニットは、30年以上にわたりスプリングコネクタの開発・提供をグローバルに展開しており、電子機器における電力供給やデータ伝送を担う中核部品としての役割を果たしてきました。特に、簡易着脱が可能な精密スプリングコネクタは、軽量・小型化が進むスマートウォッチやイヤホンなどの民生機器に加え、業務用・産業用・医療用・車載用といった多様な用途で採用が拡大しています。

グローバルに展開するスプリングコネクタの先進的ソリューション

FCビジネスユニットでは、400種類以上の標準品と5000種類を超えるカスタム製品をそろえ、小型化、ウエアラブル化といった急速に変化するニーズに的確に対応できる製品ラインナップを構築しています。また、防水、高速伝送、高電流対応といった機能の高度化にも対応し、形状・サイズ・仕様・デザインなどに関する特殊な要件にも柔軟に応えるカスタマイズ体制を強化しています。

高度化する市場ニーズに対し、当社が独自に開発したスプリングコネクタは、小型でありながら高性能を備え、限られた基板スペースにも対応可能な省スペース設計を実現しています。複雑な形状・機能に応じた柔軟な設計力を併せ持ち、幅広い電子機器に搭載される高信頼な接続部品として、顧客から高い評価を得ています。

製品の製造は日本、マレーシア、中国の3拠点で行っており、海外生産比率は80%を超えています。また、製品は国内外の幅広い分野の電子機器メーカーに供給されており、海外販売比率も80%以上に達しています。



スプリングコネクタ

スプリングコネクタの特長と主な用途



競争力の強化とともに、生産性・品質向上への取り組みを推進

スプリングコネクタ市場は他の電子部品市場と比べて独特な構造を持っています。市場全体としてのトレンドはあるものの、製品一つひとつが用途に応じた設計を必要とするため、いわゆる汎用品はほとんど存在せず、ほぼ全てが顧客の製品設計に応じたカスタム対応となっています。顧客からの要望は幅広く多様であり、具体的なニーズを正確に把握するためには、顧客との継続的かつ密接なコミュニケーションが不可欠です。このような関係性の構築が、信頼の獲得と具体的なビジネス機会の創出につながっています。

こうした市場と製品の特性を踏まえ、当社では品質の維持・向上に向けて独自の社内基準と検査メソッドを確立し、品質目標を明確に数値化したマネジメントを実践しています。従来は一部の工程において手作業に依存していた部分もありましたが、2024年度より本格的に自動化への取り組みを開始し、省人化を進めています。

今後は、これらの取り組みをさらに進化させるべく、AI技術などの活用によって熟練技能者のナレッジをデジタル化し、プロセス全体における知見の共有・活用を図ることで、生産性と品質のさらなる向上を目指しています。

次世代製品開発への挑戦

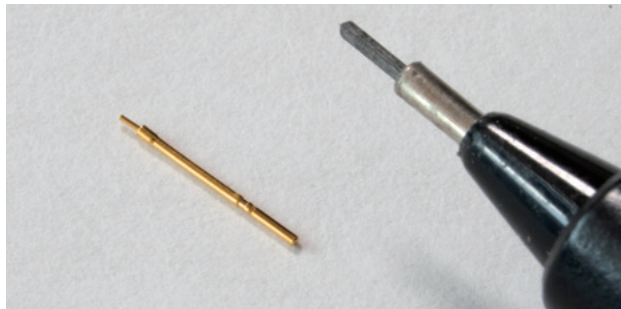
コネクタ市場においては、最終製品が普及する以前の段階から、顧客ニーズを先取りすることが市場シェアの獲得に直結します。FCビジネスユニットは、保有する技術力を生かし、これまでにない新たな製品群を提案し続けており、特にウエアラブルデバイス領域での応用展開では、遠隔医療やスポーツ、ゲームといった分野での新たな市場の創出に向けて、産学官を横断するさまざまなプロジェクトにも積極的に参画し、連携体制を構築しています。

さらに、今後の成長が見込まれるAIおよびエッジコンピューティング領域では、電力消費の増加や発熱といった課題への対応が求められており、これらに対応する次世代コネクタの開発を進めています。無線伝送やアンテナ技術の応用によって、物理的制約を超えた新たな接続ソリューションの実現に挑戦しています。

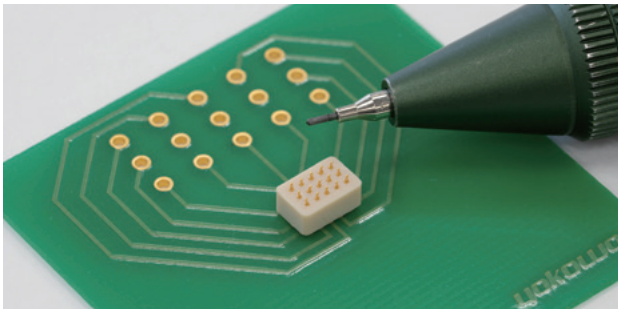
世界最小の新型スプリングコネクタによる次世代スマートデバイス対応

2024年度後半、FCビジネスユニットは世界最小クラスとなる直径0.35mmの新型スプリングコネクタを開発し、サンプル出荷を開始しました。本製品は、従来品比で約60%の小型化を達成しながら、高速伝送および高電流対応といった高性能を兼ね備えています。小型化・多極化が可能なことに加え、コネクタのカスタム設計により基板実装の占有面積を大幅に低減することができます。それによって顧客の設計自由度を大きく向上させることが可能です。また、基板周辺設計の効率化にも寄与し、製品設計プロセスに新たな付加価値を提供します。

本製品には、当社が半導体検査用プローブの開発で培ってきた微細精密加工技術を応用しています。直径0.35mmという極小チューブ内に高精度の穴加工を施す独自技術に加え、安定した導通性能を実現する金めっき処理技術、微小部品を正確に組み立てる半自動化工程など、長年の技術蓄積を生かした高度な生産体制を構築しています。



シャープペンシルの0.5mm芯よりも細い直径0.35mmのスプリングコネクタ



世界最小の新型スプリングコネクタを15本用いたコネクタ

コネクタソリューションプロバイダへの進化に向けて

FCビジネスユニットは、コア技術である微細精密加工技術の研鑽を通じた競争優位性の確立と、ヨコオならではの価値創出により、単なる部品供給にとどまらない「コネクタソリューションプロバイダ」への進化を目指しています。多様化する市場ニーズを的確に捉えたうえで、対象市場の特性に即した製品企画や拡販戦略を展開し、顧客企業の先にいるエンドユーザーに対して、より高度なUX（ユーザーエクスペリエンス）の提供を実現していきます。

私たちは、変化の激しい市場環境においても自ら事業機会を創出できる力を備えていると確信しており、今後も独自の微細精密加工技術と高いカスタマイズ対応力を強みに、信頼性の高い接続ソリューションをグローバル市場に向けて提供し続けてまいります。

MD (Medical Device)



医療機器

先端医療機器領域での競争優位性を確立

—微細精密加工とスタートアップ連携によるMD事業の挑戦—

井下原 博

執行役員常務／MD事業部長
事業リスク管理委員会委員長



MD (Medical Device) ビジネスユニットでは、微細精密加工技術や電解研磨などの独自のものづくり技術を強みとし、医療機器分野における競争優位性の確立を図っています。特にスタートアップとの連携によるイノベーションの創出や、米国FDAの510 (k) 取得を含むグローバル展開に向けた体制整備を重要な戦略課題と位置付けています。国内外の法規制や制度への的確な対応、ベンチャーエコシステムの活用、およびシミュレーションによる開発期間の短縮といった多面的な取り組みを進めています。

先端医療分野におけるMDビジネスユニットの成長戦略

MDビジネスユニットでは、国内大手医療機器メーカー向けのカテーテル用部品の受注が増加するなか、ユニット製品の販売も堅調に推移しています。これにより、安定した収益基盤を築きつつ、次なる成長に向けた布石を打っています。

当ユニットは、ヨコオのコア技術である微細精密加工技術、コーティング技術、アッセンブリ技術を活用し、最先端の生産設備導入による生産能力の強化を進めてきました。ガイドワイヤーやカテーテルのアッセンブリ製品については、国内外への拡販を推進するとともに、プロダクト・ライフサイクル全体を見据えたグローバル品質システムの構築を目指しています。ビジネスモデルとしては、①自社による設計・製造・販売を行う自律型モデル、②スタートアップの製品アイデアを具現化し、製造パートナーとして支援する「ベンチャーエコシステム型モデル」。この2軸を成長の両輪として展開、これらを強化することで先端医療分野における企画型製品開発および開発型OEMサプライヤーとしての地位確立と、持続的な事業拡大を目指します。

さらに、米国市場への参入に向けた取り組みとして、国内で第一種製造販売業を取得したのに続き、FDAの510 (k) 認可取得を次の重要ステップと位置付けています。米国市場では製品の質が価格に正当に反映される構造があり、当社の高品質な製品が評価されることで、さらなる成長機会の獲得を図っていきます。

製品ポートフォリオとグローバル戦略による成長加速

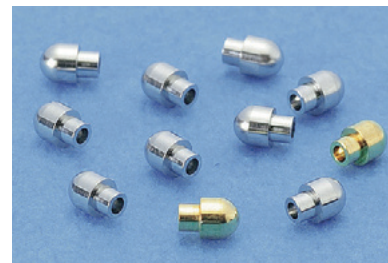
現在、グローバル市場を視野に入れた戦略的な製品ポートフォリオの構築を進めています。具体的にはハイエンド製品とローエンド製品を明確に位置付け、前者は自社設計・製販体制により高付加価値市場に展開し、米国市場を主軸とした販売を行う一方、中国市場では信頼できるパートナーを通じて供給しています。ローエンド製品については、中国パートナーと連携して製造し、日本および米国での販売を進めています。

ベンチャーエコシステムの構築とスタートアップとの協業体制

ベンチャーエコシステムの構築では、現在は4社のスタートアップと協業しており、そのうち1社は2023年12月に大手医療機器メーカーに買収され、その製品は2025年3月に上市されました。同製品には当社製のステントが初めて採用され、社会実装とベンチャー支援の両面で大きな成果となり、将来の売上増に期待を寄せています。

また、2021年12月に日本の医療機器スタートアップを支援するために熱い同志と一般社団法人JMPR (Japan Medical Start up Incubation Program) を立ち上げました。当社はJMPRへの基金を拠出してJMPRそのものの運営を支援するとともに、

JMPRが支援するスタートアップの経営／運営支援だけではなく、医療機器用の新材料／新コート液などの要素技術開発、後に述べる構造像解析シミュレーションなどを通して日本発の医療機器を目指していきます。スタートアップのアイデアを迅速に具現化し、事業として立ち上げることで、イノベーションの勝ちパターンを自社内に構築することを目指し、今後もシリアルアントレプレナー（連続起業家）との協業、支援を通じて、医療技術の進化と社会還元に貢献していきます。



カテーテル先端部



ガイドワイヤー



クリーンルーム内の部品加工

医療デバイス開発における独自技術とグローバル競争力

MDビジネスユニットでは、微細精密加工技術を基盤に、ステントをはじめとする医療デバイスの高度な開発を推進しています。とりわけ、電解研磨および流体研磨による高精度仕上げ技術は、当社が世界に誇る独自の強みであり、血管内に使用されるステント表面の滑らかさを確保することで、血栓発生リスクの低減に寄与しています。特に、内外面を同時に研磨できる流体研磨技術を有するのは世界でも当社のみとされ、その希少性が技術的優位性を裏付けています。

また、医療分野製品で不可欠な特殊金属の接合技術も有しており、この分野で同様の技術を持つ企業は世界でもごく少数に限られます。こうした高い技術力は、他のビジネスユニットとの連携によりさらに深化し、当社の医療デバイス事業における差別化と国際競争力の強化につながっています。

中長期的視点で進める事業展開

MDビジネスユニットでは、年度単位の短期的な成果よりも、中長期的な成長軸に基づく事業展開を重視しています。新規事業の立ち上げには一定の時間を要するものの、現在は着実に売上が拡大しており、今後は製造力と販売力の双方を強化することで収益性の向上を目指しています。

当社が強みとする微細精密加工技術に加え、スタートアップの研究開発力や医師からのフィードバックを積極的に取り入れ、構造解析シミュレーションや試作・改善の繰り返しを通じて製品化を推進しています。構造解析シミュレーションとは動物実験や臨床試験の一部をコンピューター上で代替することで、開発期間短縮とコスト削減を図っています。これにより、規制対応においても先進的な評価を得ており、当社メンバーの研究成果がPMDA (医薬品医療機器総合機構) や米国FDA (食品医薬品局) でも参照されるなど、国内外で高い信頼を獲得しています。今後は、こうした高度なシミュレーション技術を外部向けサービスや共同開発に展開することによるビジネスモデル化も視野に入れ、技術と知見の事業化を模索していきます。

ものづくりの強みとデータ活用によるビジネスモデルの展望

MDビジネスユニットでは、2025年度に向けて事業拡大と実績の積み上げを目指しています。ヨコオの強みである高度な「ものづくり力」は大きなアドバンテージですが、さらなる事業拡大にはデータ活用を通じたビジネスモデル構築が必要です。今後は、医療機器の早期承認を目指す「ブレイクスルーデバイス認定」などの制度も活用し、データに基づく競争優位性の確立が求められます。

また、製品性能だけで差別化を図ることが難しい現代においては、知見・データ・戦略の融合による新たな価値創出が不可欠です。当社はスタートアップとの連携を通じて、次世代型の医療ビジネスモデルを模索しており、「ものづくり」×「知のエコシステム」によるイノベーションの創出を加速させていきます。

インキュベーションセンター (Incubation Center)



ヨコオのビジネスモデル革新
MaaS、IoT、ソフトウェア

新たな価値創造に向けた挑戦

—技術立脚を基盤に、新規事業創出・ビジネスモデル革新・人財強化を推進—

横尾 健司

取締役 兼 執行役員専務／インキュベーションセンター長
地域貢献担当／一般財団法人ヨコオ育英会代表理事



インキュベーションセンターは、複雑化・多様化する社会課題の解決に貢献するべく、技術開発とビジネスモデルの革新を担う機能部門として2023年度に独立しました。ヨコオが長年培ってきた微細精密加工技術、アンテナ技術、マイクロウェーブ技術といったコア技術に加え、顧客ニーズを満たすために必要な新たな技術の創出や、外部パートナーとの連携を通じて、新市場の創造と価値提供を目指しています。

当社の技術が活用できる領域を探索するとともに、外部知見も柔軟に取り込みながら、製品・サービスの開発を推進しています。従来の「モノ売り」にとどまらず、サブスクリプションを含む「コト売り」型の提供形態への転換も視野に入れ、事業モデルの変革に取り組んでいます。

現有顧客との関係性を重要な資産と捉え、技術・人財・設備の補完を目的とした企業連携やM&A、共創型パートナーシップの構築を通じて、グループ全体の持続的成長を支える新たな事業領域の創出に挑戦しています。

MaaS・IoT分野における事業拡大に注力

ヨコオは新規成長領域として、MaaS (Mobility as a Service) およびIoT (Internet of Things) の分野での事業拡大に注力しています。これらの領域では、従来の車載向けビジネスを超えて、自動車メーカー以外の幅広い顧客を対象としたサブスクリプション型ビジネスモデルの導入を進め、高付加価値の製品・サービスを提供します。

2024年度には、スマートアンテナ技術を応用したMIMOアンテナや、レンタカー／カーシェア向けの車載鍵管理ソリューションといった先進的な製品の拡販を強化しました。これらの取り組みは、自社技術のみならず、顧客ニーズに合致した技術を有する外部パートナーとの連携を通じて推進しており、協業やM&A、共創型の企業連携を活用することで、新たな市場の創出と持続可能なビジネスモデルの構築を目指しています。

また、グローバル市場でのニーズ把握とプレゼンス向上を図るため、米国やEU域内で開催される展示会への出展を継続し、単なる製品販売にとどまらない「コト売り」へのビジネスモデル転換を加速しています。

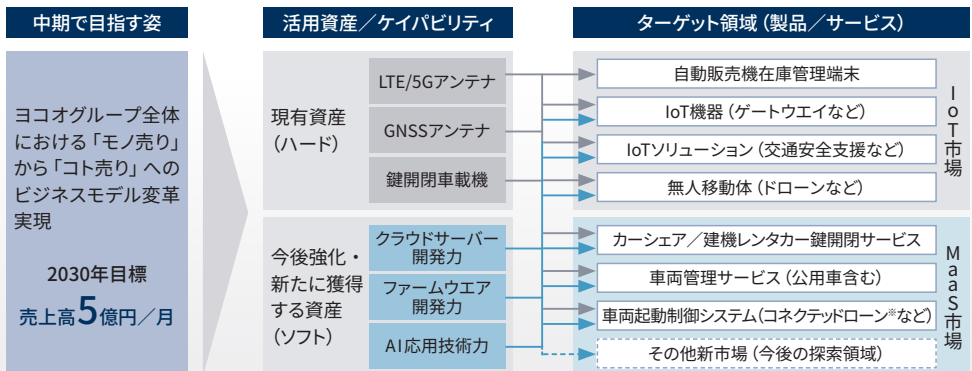


小型フルバンドGNSSアンテナ



ローカル5G専用アンテナ

新規成長領域であるMaaSとIoTでの事業拡大に注力



※ 車両に設置したIoT端末で車両の位置情報を監視しながら、ローンを組むことができるサービス。車両の盗難や異常事態への対応が可能でローン審査の通過向上も期待できる。

2025年度を事業転換の初年度と位置付け、将来成長に向けた基盤づくりを加速

インキュベーションセンターは2025年度を、新たなビジネスモデルへの転換に向けた初年度と位置付けています。過去2年間にわたり、事業基盤の強化、協力企業との提携、戦略的M&A、さらには海外マーケティング体制の構築に注力してきました。今後は、こうした取り組みで獲得した経営資源を本格的に活用し、新たな成長フェーズへと移行します。

現在は、IoTおよびMaaS領域における将来的な成長と収益化を見据え、集中的な先行投資を継続しています。特に、協力企業との連携強化や欧米市場への展開を通じて、5年・10年先を見据えた持続的な成長の基盤構築に取り組んでいます。

具体的な施策としては、ベンチャー企業2社への戦略的出資を実施しました。一つは、産業向けIoTソリューションを提供する aptpod (アプトポッド) で、自動運転分野におけるミドルウェアの開発に強みを持ち、すでに国内大手自動車メーカーとの実証実験を開始しています。もう一つは、EVの開発・販売を手がけるASFで、大手物流企業との3000台規模の契約に加え、ドラッグストアチェーン向けの導入も進んでいます。同社が展開する車両には、当社が独自に開発した車載鍵管理ソリューションが搭載されており、新たな収益モデルの構築につながっています。

加えて、米国市場における販売ネットワークの強化にも取り組んでいます。地域特性に応じた販売代理店との契約を進めており、すでに複数の引き合いが寄せられています。今後は、このネットワークを基盤に販路を拡大し、事業規模のさらなる拡充を目指してまいります。

ソフトウェア開発体制の強化に向けた取り組み

2024年度まで、当社におけるソフトウェアエンジニアは限られた人員で構成されており、既存システムの開発・運用に注力していたため、海外展開や新規開発へのリソース配分が困難な状況が続いていました。

こうした課題を解決すべく、2024年度には有力な開発力を有する企業のM&Aを実施し、2025年度に入ってPMI (統合プロセス) を開始しました。これにより、約30名のソフトウェアエンジニアを新たに迎え入れ、新規事業の創出や開発体制の強化に向けた基盤の確立を進めています。

今後は、トップ・エンジニアを中心に、全社横断型のソフトウェアチームの設置を2年以内に実現する方針です。インキュベーションセンターには実働部隊を配置しつつ、外部採用や他事業部門でのM&Aも視野に入れ、全社的なソフトウェア人材の拡充と技術力の向上を推進します。

技術立脚型企業としての進化をけん引する役割

インキュベーションセンターは、ヨコオが技術立脚型企業としての方向性を堅持しながら、新規事業の創出や他社との連携によるビジネスモデルの革新、さらにそれを支えるソフトウェア人材の強化や社員のマインドセット変革を推進する中核的な機能を担っています。

今後は、ハードウェア中心の開発・販売から、ソフトウェアやサービスを含む「コト売り」型のサブスクリプションビジネスへの転換を加速していきます。そのためには、マーケティング力やソフトウェア開発への注力といった、新たな視点と姿勢が不可欠であり、全社的な意識改革が求められます。

とりわけ重要となるのが、まだ顕在化していない課題を的確に見だし、商品化へとつなげる「課題発見力」です。現場感覚と即応力を持ち、顧客の潜在的ニーズをいち早く捉えることが、新たな価値創出の鍵を握ります。

その実現には、一人ひとりの社員が従来の枠組みにとらわれず、変化を前向きに受け入れるマインドセットを持つことが重要です。特にエンジニアには、より広い視野と柔軟性を持って、新たな技術や事業領域への挑戦が期待されます。

インキュベーションセンターを起点に、既存事業とのシナジーを最大限に生かしながら、社会課題の解決につながる新たな市場の開拓と持続可能なビジネスモデルの構築に挑んでまいります。